

日本产LTCC陶瓷生带 其他

产品名称	日本产LTCC陶瓷生带 其他
公司名称	台湾三昌商事股份有限公司苏州办事处
价格	.00/个
规格参数	特性:低温共烧陶瓷 (LTCC) 功能:多种电子器件用陶瓷基板 微观结构:其他
公司地址	中国 江苏 苏州市 新区狮山路35号金河国际大厦1208
联系电话	86 0512 68089308

产品详情

特性	低温共烧陶瓷 (LTCC)	功能	多种电子器件用陶瓷基板
微观结构	其他	规格尺寸	150 × 150 (mm)

日本大厂生产ltcc陶瓷生带			
低温共烧陶瓷技术 (lowtemperature cofiredceramic ltcc) 是近年来兴起的一种相当令人瞩目的多学科交叉的整合组件技术,以其优异的电子、机械、热力特性已成为未来电子元件集成化、模组化的首选方式,广泛用于基板、封装及微波器件等领域。			
< ltcc基板特征及应用领域 >			
高频、高速传输。以应对日益高频化的电子器件,如应用于无线区域网络、蓝牙组件等。			
高密度组装。使电子器件多机能化,如应用于pda、手机组件等。			
高信赖性。可应用于恶劣环境,如汽车电子组件等。			
高散热性。可适应大电流及耐高温特性要求,如mpu等。			

<规格>				
		种类1	种类2	种类3
基板特性	介电常数 ()	5.0	7.1	10.0
	介电损耗 (tan δ × 10 ⁻⁴)	30 (at.1mhz)	30 (at.1mhz)	30 (at.1mhz)
	烧结体密度 (g / cm ²)	2.3	2.85	3.0
	抗弯强度 (mpa)	120	250	280
	热膨胀系数 (ppm / °C)	3.9	5.5	6.0
生带特性	x-y收缩率 (%)	12.7	13.1	13.5
	z收缩率 (%)	(32)	(30~32)	(30~32)
	生带尺寸 (mm)	100 ~ 500	100 ~ 500	100 ~ 500
	厚度 (μ m)	20~200	20~300	20~300

另外还有多种规格产品对应，如需更详细的材料，请与我司营业联系，谢谢！